

华进半导体封装先导技术研发中心有限公司
“华进半导体封装先导技术研发中心有限公司半导体封装
研发项目（补充验收 1 台铜硅抛光一体机）”
竣工环保验收意见

根据国务院《建设项目管理条例》（国务院令[2017]第 682 号）、环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）、第二十四号主席令（2018 年 12 月 29 号）的要求，2019 年 6 月 11 日，华进半导体封装先导技术研发中心有限公司（以下简称该公司）在公司内主持召开了“华进半导体封装先导技术研发中心有限公司半导体封装研发项目（补充验收 1 台铜硅抛光一体机）”（以下简称本项目）环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、验收监测单位等单位代表共 7 人，会议邀请 2 名专家组成专家组。与会代表和专家查阅了项目环评报告及批复，踏勘了工程现场，听取了建设单位关于项目基本情况介绍、监测单位对于竣工验收监测情况的介绍，经认真讨论形成如下意见：

一、项目基本情况

华进半导体封装先导技术研发中心有限公司成立于 2012 年 9 月，位于无锡新区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 D1 栋，由中科院微电子所和集成电路封装产业龙头企业长电科技、通富微电、华天科技、深南电路、苏州晶方、安捷利（苏州）、中科物联、兴森快捷、国家开发银行十家单位共同投资而建立。

该公司现有项目“华进半导体封装先导技术研发中心有限公司半导体封装研发项目”，其环评报告表已于 2015 年 7 月 20 日通过无锡市环境保护局（锡环表新复[2015]143 号）审批。以上项目已于 2016 年 6 月 27 日通过无锡市环境保护局（锡环管新验[2016]97 号）审批。但当时验收中以下设备未到位：铜硅抛光一体机 1 台、表面贴装锡膏印刷机 1 台、电化学沉积台 1 台、凸点自动检测仪 1 台、晶圆级封装自动测试机 1 台，故当时验收内容不包括以上设备。此后，1 台电化学沉积台设备到位，已于 2019 年 2 月完成水、气、声、固体废弃物竣工环保验收。

如今，该公司 1 台铜硅抛光一体机已如环评申报数量到位，其他设备仍未到位，故本次验收是对“华进半导体封装先导技术研发中心有限公司半导体封装研发项目”的补充验收，即为本项目，本次验收范围为“铜硅抛光一体机生产设备 1 台”对应的环保验收。

本项目已于 2019 年 4 月开始生产调试。2019 年 4 月 24 日~25 日进行了现场监测和环境管理检查，验收监测单位为无锡精纬计量检验检测有限公司。

二、工程变动情况

经核对，本项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、生产设备和数量、污染防治措施与环评和批复要求均一致，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目只针对一台铜硅抛光一体机，其对应生产工序为“研磨”。在此生产设备不工作期间，用纯水保持其处于湿润状态，此纯水循环使用，只补充损耗不

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，全厂水、气（无）污染物排放总量符合环评、批复要求。

五、验收结论

通过现场踏勘和对验收监测报告的审查，项目环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常，验收监测期间排放的污染物满足验收标准要求，符合竣工环保验收条件。本项目水、气、声污染防治设施通过竣工环保自主验收。

华进半导体封装先导技术研发中心有限公司

2019/6/11

